

DRAM

組み込みアプリケーション向け Kingston LPDDR4/LPDDR4x DRAM

Kingston ディスクリート LPDDR4/LPDDR4x DRAM は、組み込みアプリケーションのニーズを満たすように設計されており、低消費電力で高速なオプションを提供します。

市場セグメント



産業用 IoT / ロボティクス & ファクトリーオートメーション



オフィス機器、医療機器、ATM、自動販売機



スマートホーム (サウンドバー、サーモスタット、 フィットネス機器、掃除機、ベッド、蛇口)



5G ネットワーク/通信モジュール (WiFi ルーター、 メッシュデバイス)



モバイルアプリケーション、ハンドヘルド



スマートシティ (HVAC、照明、電力監視/計測、パーキングメーター)

主な特長

- ダブルデータレートアーキテクチャ:1クロックサイクルに2回のデータ転送
- 8 ビットプリフェッチパイプラインアーキテクチャにより高 速データ転送を実現
- 双方向差動データストローブ (DQS と /DQS) は、レシーバーでデータをキャプチャするためにデータと共に送受信されます
- DQS は、READ の場合はデータとエッジアライメントされ、WRITE の場合はデータとセンターアライメントされます
- 差動クロック入力 (CK_t と CK_c)
- DLLは DQ と DQS の移行を CK の遷移に合わせます
- データマスク (DM) は、データストローブの立ち上がりエッジと立ち下がりエッジの両方でデータインを書き込みます
- 書き込みサイクル冗長コード (CRC) をサポート
- プログラム可能な読み取り/書き込み用プリアンブルをサポート
- プログラム可能なバースト長 4/8、ニブルシーケンシャルモードとインターリーブモード両方に対応
- オンザフライの BL スイッチ
- MRS によって選択されるドライバー強度
- ダイナミックオンダイ終端をサポート
- ODT ピンによって RTT_PARK と RTT_NOM の 2 つの終端状態を 切り替え可能
- 非同期 RESET ピンをサポート
- ZQ キャリブレーションをサポート
- 書き込みレベライゼーションをサポートV
- この製品は、RoHS 指令に準拠しています
- 内部 Vref DO レベル生成が可能
- TCAR (温度制御自動リフレッシュ) モードをサポート。
- LP ASR (省電力自動セルフリフレッシュ) モードをサポート
- コマンドアドレス (CA) パリティ (コマンド/アドレス) モード をサポート
- DRAM 単位のアドレス指定能力 (PDA)
- きめ細かいリフレッシュをサポート
- ギアダウンモード (1/2 レート、1/4 レート) をサポート
- セルフリフレッシュアボートをサポート
- 最大消費電力モードをサポート
- バンクグループ化を適用し、同一バンクグループまたは 異なるバンクグループアクセスの CAS 間レイテンシー (tCCD_L、tCCD_S) を利用可能
- 書き込みデータマスキングと DBIdc 機能のための DMI ピンサポート
- 低消費電力
- バンク単位のリフレッシュ
- JEDEC 低消費電力ダブルデータレート 4 (LPDDR4) 仕様に完全 準拠
- パーシャルアレイセルフリフレッシュ (PASR)
 - o バンクマスキング
 - o セグメントマスキング
- 自動温度補償型セルフリフレッシュ
 - o (ATCSR) 内蔵温度センサーによる o 全バンク自動リフレッシュとバンク単位の自動リフレッ シュをサポート
- ダブルデータレートアーキテクチャ:1クロックサイクルで2回のデータ転送
- ダブルデータレートアーキテクチャ:1クロックサイクルで2回のデータ転送
- 書き込みデータマスキングと DBIdc 機能のための DMI ピンサポート

LPDDR4 製品番号と仕様

商用温度

部品番号	容量	説明	パッケ ージ	構成 (ワー ドxビット)	速度 Mbps	VDD, VDDQ	動作温度
D1621PM4CDGUI-U	16Gb	200 ボール FBGA LPDDR4 C-Temp	10x14.5x0.8	512Mx32	3733 Mbps	1.1V	-25°C ∼ +85°C
D1611PM3BDGUI-U	16Gb	200 ボール FBGA LPDDR4 C-Temp	10x14.5x0.8	1Gx16	3733 Mbps	1.1V	-25°C ∼ +85°C
C3222PM4CDGUI-U	32Gb	200 ボール FBGA LPDDR4 C-Temp	10x14.5x0.8	1Gx32	3733 Mbps	1.1V	-25°C ∼ +85°C
B3221PM3BDGUI-U	32Gb	200 ボール FBGA LPDDR4 C-Temp	10x14.5x0.8	1Gx32	3733 Mbps	1.1V	-25°C ∼ +85°C
Q6422PM3BDGVK-U	64Gb	200 ボール FBGA LPDDR4 C-Temp	10x14.5x1.0	2Gx32	4266 Mbps	1.1V	-25°C ∼ +85°C

産業温度

部品番号	容量	説明	パッケ ージ	構成 (ワー ドxビット)	速度 Mbps	VDD, VDDQ	動作温度
D1621PM4CDGUIW-U	16Gb	200 ボール FBGA LPDDR4 I-Temp	10x14.5x0.8	512Mx32	3733 Mbps	1.1V	-40°C ∼ +95°C
D1611PM3BDGVIW-U	16Gb	200 ボール FBGA LPDDR4 I-Temp	10x14.5x0.8	1Gx16	4266 Mbps	1.1V	-40°C ∼ +95°C
C3222PM4CDGUIW-U	32Gb	200 ボール FBGA LPDDR4 I-Temp	10x14.5x0.8	1Gx32	3733 Mbps	1.1V	-40°C ∼ +95°C
B3221PM3BDGVIW-U	32Gb	200 ボール FBGA LPDDR4 I-Temp	10x14.5x0.8	1Gx32	4266 Mbps	1.1V	-40°C ∼ +95°C

LPDDR4x 製品番号と仕様

商用温度

部品番号	容量	説明	パッケ ージ	構成 (ワー ドxビット)	速度 Mbps	VDD, VDDQ	動作温度
D1621XM4CDGVI-U	16Gb	200 ボール FBGA LPDDR4x C-Temp	10x14.5x0.8	512Mx32	4266Mbps	0.6V	-25°C ∼ +85°C
B3221XM3BDGVI-U	32Gb	200 ボール FBGA LPDDR4x C-Temp	10x14.5x0.8	1Gx32	4266Mbps	0.6V	-25°C ∼ +85°C
Q6422XM3BDGVK-U	64Gb	200 ボール FBGA LPDDR4x C-Temp	10x14.5x1.0	2Gx32	4266Mbps	0.6V	-25°C ∼ +85°C



